

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年5月28日-5月29日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	华福证券、长城证券、胜钧资本、银华基金、中邮证券、广发基金、东方证券资管、交银施罗德基金、嘉实基金、兴业基金、安信基金、农银汇理基金、中信保诚基金、金鹰基金、海富通基金、招银理财基金、上银基金、国联基金、鑫元基金、太平洋保险资管、国寿安保基金、中海基金、泰信基金
活动时间	2024年5月28日、5月29日
活动地点	策略会、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。 二、交流的主要问题及答复 1、公司目前 SLC NAND 有哪些新产品的规划？答：公司基于 2xnm 制程，持续进行 SLC NAND Flash 产品系列的研发，不断扩充产品线，新产品陆续进入研发设计、首次晶圆制备、晶圆测试、样品送样等关键阶段。公司积极推进先进制程的 1xnm SLC NAND Flash 产品的研发及产业化进程，前期已完成晶圆制造和功能验证，目前正处于晶圆测试及工艺调整阶段，以进一步提升产品可靠性水平。2、今年的研发费用方面公司是怎样的规划？答：公司坚持自主研发，在中小容量存储芯片领域继续保持高水平研发投入，不断丰富产品线，推进产品制程迭代，提高产品可靠性水平。另一方面，为进一步丰富公司产品品类，以存储为

	<p>核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，投入研发力量从事 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计。公司 2024 年一季度研发费用 4,887.21 万元，同比增长 37.50%。</p> <p>3、能否介绍一下公司的 DRAM 产品？答：公司研发的 DDR3(L)系列是可以传输双倍数据流的 DRAM 产品，具有高带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领域应用广泛；公司针对移动互联网和物联网的低功耗需求，自主研发的 LPDDR1/2/4X 系列产品具有低功耗和高传输速度等特点，最大时钟频率可达 2133MHz，适用于智能终端、可穿戴设备等产品。</p> <p>4、人员配置方面公司今年是怎样的计划？答：2024 年公司将在保障现有人才队伍稳定的同时，扩大研发团队规模，配备不同层次的研发人员，进一步提升公司的创新能力和技术水平，确保各项技术升级和产品研发目标的实现。公司也将积极进行管理、市场、销售等领域优秀人才的引进与培养，优化人员结构，提升公司的产品销售能力和运营管理水平，确保公司业务的稳定发展。此外，公司将完善人才激励机制，加强各种形式的在岗培训，为各个岗位的员工提供多样化的发展空间，吸纳更多优秀的人才为公司长期服务。</p> <p>5、业务方面公司主要往哪些方向重点发力？答：公司将以存储业务为核心，兼顾产业链上下游的整合，尽可能多的在客户端导入公司更多产品，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案，提升营收体量，分摊周期风险。公司将继续聚焦高附加值产品，顺应汽车产业在智能网联功能的布局，大力发展在工艺技术、使用环境、抗振能力、可靠性等方面比消费级、工业级存储芯片要求更高的车规级存储芯片，实现车规级闪存产品的产业化目标。</p>
日期	2024 年 5 月 30 日